

덱스보드 벽패널 (덱스퀘어 W 10T-NMT) 특기 시방서

1. 일반개요

불연 방화 방수 석고보드 스틸 (금속) 절곡 복합재료를 사용한 제품이며 내식성, 내화성, 내수성, 내마모성, 내약품성, 치수변화율, 내광성 등이 우수하고 습기와 내식성 화재오염에 강한 복합 신소재임.

2. 난연성능기준

국토 해양부 고시 제2011-39호(건축물 마감 재료의 난연 성능기준)
KS F ISO 1182 건축 재료의 불연성 시험방법

3. 제품특성

POSMAC 3.0 (포스맥) 은 동일한 도금 부착량의 일반 용융아연도금강판(GI, GI H) 대비 5~10배이상의 내식성을 보유한 제품으로 특히 절단면의 내식성이 매우 우수함.

4. 화학적 성능

- 가. 내화성 : 분해온도 900° C 에도 형체가 유지되어야 함
- 나. 내수성/내식성 : 물속 /염수에 장시간 담구어도 결점 없음
- 다. 내마모성 : 마모값 200이상 (KS M 3803)
- 라. 내약품성 : 산, 알칼리에 변화가 없음 (KS M 3803)
- 마. 치수변화율 : 종방향 0.7%이하, 횡방향 1.2%이하 (KS M 3803)
- 바. 내광성 : 60° C, 48 hr 노출 시 결점 없음 (KS M 3803)

* W 10T-덱스보드 (직합 공법)

가. 덱스보드 벽패널 (뉴엠텍 C&C W 10T)을 전동 톱으로 절단할 때 발생하는 분진으로부터 눈과 호흡기 계통을 보호하기 위하여 보안경 및 방진마스크를 착용하여야 한다.

나. 먼저 시공하려는 구조 벽체면 천정 및 바닥에 30*30 목상 또는 메탈 스테드를 수직으로 세워 런너와 체결 시키고 콘크리트 타카못으로 고정하여 수직·수평을 잡아 바탕면을 세운다.

다. 다음 바탕면의 방화 방수 석고보드&합판에 고정한다 (하지작업) 먼지, 기름때, 물기 등 이물질을 깨끗이 제거하여 접착제가 잘 부착되도록 바탕면을 청소하여야 한다.

라. 텍스보드 벽패널 (텍스퀘어 W 10T)은 Shop-drawing에 준하여 바탕면 위에 수직·수평 먹메김을 정확히 한다. 먹메김 후 패널을 디자인에 맞게 재단한다.

마. 시공시 패널을 절단할 경우엔 전동 그라인더를 사용한다.

바. 재단한 각각의 패널을 뒷면에 실리콘 및 핫멜트 접착제를 규정된 접착제 도포 위치에 따른 적합한 도포방법으로 균일하게 도포한 다음 핫멜트가 굳기 전 신속히 먹메김 줄에 맞춰 압착한다. 먹메김 줄에 맞춰 부착된 패널을 흠에 끼운다.

사. 접착제는 투명 무초산 실리콘 접착제, 핫멜트를 사용하되 도포하기 전에 물성저하 원인이 될 수 있는 물 또는 기타 희석제가 바탕면을 오염시키지 않도록 주의한다.

아. 텍스보드 벽패널 (뉴엠텍 C&C W 10T)을 부착한 후 패널보호필름을 벗겨내고 인코너부분은 AL몰딩 혹은 코킹 처리로 마감한다.

자. 접착제 사용시 저온에서는 접착불량의 원인이 되므로 실내온도가 5도씨 미만일 때는 시공을 중지하여야 하며, 시공을 감행할 경우에는 접착제가 완전히 경화될 때까지 실내표준온도를 15~25도씨로 유지하여야 한다.

차. 텍스보드 벽패널 (뉴엠텍 C&C W 10T)을 바닥을 수평으로 하여 빠릿트등 평탄한면 위에 지면으로부터 20cm이상 띄어 적재함과 동시에 습기에 과다하게 노출되지 않도록 비닐 등으로 포장하여 직사광선을 피하여 보관하고 운반시에는 표면손상이나 모서리가 파손되지 않게 주의하여야 한다.